# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-41118

(i)Int Cl. 4

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)2月22日

B 29 C 45/40

6949-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

樹脂成形金型装置

②特 顖 昭61-186006

顖 昭61(1986)8月7日 20世

切発 明 者

秀 穂 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

70代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称

樹脂成形金型装置

2、特許請求の範囲

樹脂成形品のポス又はリブ部先端を射出成形法 中において加圧可能なカム及びピンと、このカム 及びピンを駆動する駆動部とからなる樹脂成形金 型装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は射出成形により樹脂成形品を得る際に 製品裏面のポスやリプによる収縮の不均一に起因 する製品表面のヒケを防止する樹脂成形金型装置 に関するものである。

従来の技術

一般に、射出成形により樹脂成形品を得る加工 では冷却に起因するヒケと呼ばれる製品表面のく **輝みが製品肉厚の不均一をところに発生し製品外** 観を若しく損ない商品価値を失ないがちである。 第3図及び第4図はそのヒケ発生の例である。第

3図では製品1の裏面に立ったポス2により製品 表面に数十ミクロンのヒケ(くぼみ)4が発生し 外観不良となっている。これは製品肉厚るとポス 2との組み合わせによりポスの根元4において肉 厚が他の部分と異なる為収縮の不均一が起こる為 である。第4図でも同様をヒケ8が今度は板状の 製品リプロにより発生している。樹脂製品5の蔓 面にリプロが存在すると製品板厚てとの関係から リブの長さ方向に沿ったヒケ8が発生し表面に となって現われる。このようなヒケは樹脂成形品 の樹脂を充てんするゲートから遠い箇所に多数発 生し特に大型の製品の成形の際の大きな障害とな ることが多い。これらのヒケを防止する為、従来 は第8図に示すどとく成形機による射出が完了後 更に高い圧力を付与し樹脂の体積収縮を補てんす る方法がとられている。

すなわち第5図は射出成形保圧工程における圧 力付与を表わす。樹脂が充てん後更に高い圧力 (保圧)が成形機ノズル9から付加されゲート10 を経て製品部11及びポス部12に13に示す如

く 一様に圧力がかかる。但し冷却が進行すると一様性がくずれ末端圧力は急酸に減少する。

発明が解決しようとする問題点

b

問題点を解決するための手段

本発明は樹脂成形品の成形中の圧力の低下を補 う為ポス又はリブ部の先端に射出成形途中におい と、このカム及びビン て加圧可能なカム及びビンを駆動する駆動部を有

例であるが所定圧力はポスに中空を生じせしめるピン29を介し付加される。すなわち、中空のポス27に予想されるヒケ28を防止する為圧力が、油圧装置26、テーパーカム25を経てセンターピン29を押し上げることによりポス27に付与される。特にこの形状の場合スチール製ピン29と樹脂27との熱彫張率の違いから冷却時にピン29が伸縮しヒケ28を発生させる為従来のように樹脂充てん後高圧の保圧を付与してもヒケを解消することは難しいが本発明の装置により解決される。

この実施例により金型表面のヒケ電が従来製品では30 g~70 g以上あったものが20 g以下に減少し製品外観品質の大幅な向上を見た。

発明の効果

以上、本発明によると、カム及びピンを射出成 形中に押圧する構成であるため、製品の収縮を抑 え、製品表面のヒケを防止できる。

#### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における樹脂成形金

. - .

したものである。

作,用

本発明は、上記の構成により、カム及びピンを、 射出成形中に押圧することにより製品収縮を抑え 製品表面のヒケを防止することを可能とする。

#### 実 旅 例

以下、本発明の一実施例を図により説明する。第11回は本発明の実施例である。溶融樹脂はスプルー20を経て製品部21及びボス部22に充てんされる。製品は冷却、収縮型板17及び18を19で分けることにより取り出される。点線部23は本実施例を実施しない時に予想されるボス22によるとケである。樹脂が充てん後ことによりとケは完全に防止される。このピン24は金型18の側面に取り付けた油圧装置28と移動するテーバーを防止するのに必要な100kg/cml以上のたボス22内の溶融樹脂に伝える。

第2図は中空のポス27をもつ製品に適用した

型装置の要部断面図、第2図は他の実施例における樹脂成形金型装置の要部断面図、第3図,第4 図はヒケ発生を示す製品の斜視図、第5図は従来のヒケ防止の説明図、第6図は圧力と時間との関係図である。

22……ポス部、24……ピン、25……カム。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

### 特開昭63-41118 (3)

第 1 図











